

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Osamu Mochikami, Hidefumi Asano, Yujiro Katoh, Shugo Kubo. // Jap. Jornal of Appl. Phys. 1987. V. 26. N 7. P. L1199-L1201.
- [2] Hellman E.S., Schlom D.G., Missert N., Char K., Harris J.S. // J. Vac. Sci. and Technol. 1988. B 6. N 2. P. 799-803.
- [3] Budhani R.C., Tzeng S.H., Dorr H.J., Buhshah R.F. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51. P. 1277-1281.
- [4] May P., Jedamzik D., Miller P. // Supercond. Sci. Technol. 1988. V. 1. P. 1-4.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
13 марта 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 8

26 апреля 1989 г.

02; 05.2

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

Э.Н. Соболь

Одной из особенностей высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) является относительно низкое значение порога лазерной абляции W_0 , при воздействии лазерных импульсов длительностью $\tau = 30$ нс на пленки $YBa_2Cu_3O_x$ $W_0 = 0.11 \text{ Дж}\cdot\text{см}^{-2}$, что не может быть объяснено существующими моделями плавления и испарения вещества [1, 2].

В настоящей работе рассмотрен механизм лазерного разрушения ВТСП, связанный с выделением кислорода при термическом разложении керамики. Установлено, что при достижении некоторой плотности энергии излучения W возникает колебательный режим, при котором температура T и давление кислорода P на фронте химической реакции меняются со временем немонотонно, причем в определенных условиях процесс носит неустойчивый характер, что приводит к значительному перегреву поверхности и к резкому увеличению P . Показано, что кинетика лазерного разложения, механизм и величина порога абляции зависят от пористости керамики θ , от характерного размера пор r , а также от τ .

Процесс нагрева ВТСП лазерным излучением описывается известным решением задачи теплопроводности с объемным источником тепла $A W \tau^{-1} \alpha \exp(-\alpha z)$, где A - поглощательная способность, α - коэффициент поглощения. Пусть разложение материала начинается при достижении на поверхности температуры T_0 . Представив химическую реакцию в виде $C \rightleftharpoons B + kO_2$, где B - твердые продукты разложения, k - число молекул кислорода, соответствующих одной молекуле исходного вещества C , получим величину давления кислорода

$$P = P_0 \exp(-E_f T^{-1}), \quad P_0 = \exp(\alpha S R^{-1} k^{-1}). \quad (1)$$

Здесь $E_f = \Delta H R^{-1} k^{-1}$, R - газовая постоянная, ΔH и ΔS - соответственно изменения энталпии и энтропии при разложении ВТСП.

В начале процесса слой твердых продуктов не оказывает заметного сопротивления выносу кислорода, кинетика разложения определяется энергией активации перехода атомов через границу раздела фаз и темпом подвода тепла. Тогда в первом приближении, аналогично [3], запишем для скорости движения фронта химической реакции:

$$\sigma = c_0 \exp(-E_f T^{-1}) \quad (2)$$

c_0 - константа порядка скорости звука в керамике.

С увеличением толщины слоя $z(t)$ удаление кислорода затрудняется. Анализ механизмов и кинетики переноса газов в растущих слоях новой фазы с учетом их пористости дает [4]:

$$\sigma = \frac{ds}{dt} = F s^{-1}, \quad F = DPM(kRT)^{-1}. \quad (3)$$

Здесь D - эффективный коэффициент переноса, M - молекулярный вес, P - плотность ВТСП. В соответствии с [4]

$$D = D_0 T^{\epsilon} P^{-1} + D_1 r^2 P T^{-\epsilon}, \quad \sigma = B_1 s^{-1} T^{\epsilon-1} + B_2 s^{-1} \exp(-2E_f T^{-1}), \quad (4)$$

где $D_0, D_1, B_1, B_2, \epsilon$ - постоянные. В формулах (4) первые члены отвечают газовой диффузии в порах, которая определяет кинетику массопереноса при относительно небольших T , а вторые члены описывают процесс фильтрации, преобладающий при $T > T_c$.

Величина T_c находится из условия $\frac{\partial D}{\partial T} = 0$.

Значение s_0 , при котором разложение начинает лимитироваться переносом кислорода, найдем, приравнивая величины σ из формул (2) и (4).

$$s_0 = B_1 c_0^{-1} T^{\epsilon-1} \exp(E_f T^{-1}) + B_2 c_0^{-1} \exp(-E_f T^{-1}).$$

Для определения функции $T(t)$ необходимо рассмотреть соответствующую задачу теплопроводности в области с движущейся

границей, на которой выполняется кинетическое условие (2) либо (4) [5]. Чтобы не усложнять анализ второстепенными деталями, пренебрежем различием теплофизических свойств пленки и подложки (характеристики $YBa_2Cu_3O_x$ и фианита отличаются незначительно [6]). Тогда при $s \ll \min\left\{s_0, \frac{1}{\alpha}, \frac{W}{c \pi T_0}\right\}$, где c – теплоемкость керамики, процесс разложения может быть описан аналогично задаче о сублимации твердого тела [7], из решения которой следует существование области немонотонного изменения со временем температуры и скорости движения границы раздела фаз. Используя условие существования колебательных режимов [7], найдем для $YBa_2Cu_3O_x$ (при $\Delta H = 43.7$ КДж моль $^{-1}$, $\Delta S = 32.8$ Дж·моль $^{-1}$, $k = 0.25$, $c_0 = 3 \cdot 10^5$ см \cdot с $^{-1}$, $A = 0.8$, $\alpha = 5 \cdot 10^4$ см $^{-1}$, температуропроводности $a = 7 \cdot 10^{-3}$ см 2 с $^{-1}$, теплопроводности $\kappa = 2.2 \cdot 10^{-2}$ Вт \cdot см $^{-1}$ град $^{-1}$ [6, 8], $\tau = 30$ нс) диапазон значений W , в котором должны происходить осцилляции температуры и давления, от 0.1 до 10 Дж \cdot см $^{-2}$. Таким образом, порог аблации 0.11 Дж см $^{-2}$ соответствует границе области колебательных режимов. В процессе разложения ВТСП температура фронта химической реакции существенно превышает равновесное значение T_0 , то в соответствии с (1) обуславливает резкое увеличение давления газа, которое приводит к разрушению поверхностного слоя.

При анализе кинетики разложения (до наступления момента разрушения) следует учитывать затраты энергии на нагрев слоя новой фазы, а при $s > s_0$ использовать вместо (2) граничное условие (4), что приводит к изменению кинетики процесса при сохранении его колебательного характера. Как показывает анализ, при $T < T_1$ функции $T(t)$ и $s(t)$ возрастают, а $\sigma(t)$ слабо убывает со временем. При $T > T_1$ изменение преобладающего механизма массопереноса газов обуславливает возникновение положительной обратной связи: увеличение T приводит к повышению P , что вызывает ускорение фильтрации и увеличивает скорость движения фронта химической реакции, который перемещается в более нагретую область; при этом температура фронта повышается еще сильнее, и происходит резкое возрастание давления. В отличие от затухающих колебаний параметров лазерной сублимации [7] колебательные режимы разложения ВТСП при $T > T_1$ становятся неустойчивыми.

Поскольку величина s_0 растет с температурой быстрее, чем s , то в процессе роста слоя при определенном значении T_2 (при котором $s = s_0$) массоперенос перестанет лимитировать кинетику разложения, и колебания $T(t)$ и $P(t)$ (если они не привели к разрушению) приобретут затухающий характер. Поэтому рассмотренная неустойчивость развивается в определенном диапазоне температур $T_1 < T < T_2$. Оценки для $YBa_2Cu_3O_x$ при $r = 0.4$ мкм, $T_0 = 1250$ К дают $T_1 = 1700$ К; $T_2 = 2600$ К; $P(T_1) = 30$ атм; $P(T_2) \approx 2000$ атм.

Температура плавления продуктов разложения керамики составляет ~ 1600 К [2], и наиболее вероятным механизмом начальной

стадии аблации является разбрызгивание оплавленного слоя под действием всплесков давления выделяющегося кислорода. При увеличении W и τ перегрев поверхности должен привести к развитию процесса испарения. В этом случае кинетика аблации может быть описана с помощью модели [9]. Энергоемкость такого процесса на порядок величины больше W , что соответствует экспериментальным результатам [1, 2].

Таким образом, для начала разрушения поверхности ВТСП достаточно обеспечить колебательный режим разложения. Однако расчет нагрева полуограниченного тела для рассмотренного выше примера дает максимальное значение температуры $1150 \text{ K} < T_0$, т.е. величины $0.11 \text{ Дж} \cdot \text{см}^{-2}$ недостаточно для начала химической реакции.

Необходимые условия локального перегрева реализуются при наличии в керамике пор размерами $r \gg \sqrt{a\tau}$, которые способны теплоизолировать лежащие над ними слои. Иначе говоря, существует предельная длительность лазерного импульса $\tau_o = r^2/\alpha$, при которой может проявляться рассмотренный механизм аблации. Значения τ_o составляют 60 нс при $r = 0.4 \text{ мкм}$ и 6 мкс при $r = 4 \text{ мкм}$. При $\tau > \tau_o$ следует ожидать существенного увеличения порога аблации.

Если среднее расстояние между порами $\ell \gg \sqrt{r}$, то разрушение должно носить очаговый характер. Поскольку $\ell \approx N^{-1/2}$; $N = \theta(\pi r^2)$, где N – число пор на единице площади, то данное условие выполняется при $\theta \ll 0.2$. В противном случае отдельные очаги могут объединяться, и разрушению подвергнется большая доля облучаемой площади.

В заключение сделаем два замечания. Возникновение осциляций давления кислорода возможно не только при разложении, но и при низкотемпературных фазовых переходах, происходящих в ВТСП с выделением кислорода. Оценки показывают, что вследствие относительно небольших значений энергии активации [8] возникающие давления невелики и не могут привести к разрушению. Конкурирующий механизм аблации может быть связан с термическими напряжениями. Оценки показывают, что в процессе лазерного нагрева до температуры плавления сжимающие напряжения не превышают предела прочности керамики, а растягивающие напряжения, обусловленные разницей коэффициентов линейного расширения пленки и подложки могут привести к отслаиванию пленок толщиной $h \approx \sqrt{a\tau}$. Для рассмотренного выше примера $\tau = 30 \text{ нс}$, $h = 1 \text{ мкм}$ выполняется соотношение $\sqrt{a\tau} < \alpha^{-1} \ll h$, то есть хрупкого разрушения быть не должно.

Автор выражает признательность С.И. Анисимову, А.Н. Жерихину и Ф.А. Чудновскому за плодотворное обсуждение работы.

Список литературы

- [1] Inam A., Wu X.D., Venkatesan T
Ogale S.B. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51.
N 14, P. 1112–1114.

- [2] Venkatesan T., Wu X.D., Inam A., Wachtman J.B. // Appl. Phys. Lett. 1988. V. 52. N 14. P. 1193-1195.
- [3] Анисимов С.И., Имас Я.А., Романов Г.С., Ходыко Ю.В. Действие излучения большой мощности на металлы. М.: Наука, 1970. 272 с.
- [4] Соболь Э.Н. // Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10. № 1. С. 40-44.
- [5] Людов Б.Я., Соболь Э.Н. // ИФЖ. 1983. Т. 45. № 4. С. 670-687.
- [6] Fischer H.E., Watson S.K., Cahill D.G. // Comments on Condensed Matter Physics. 1988. V. 14. N 2. P. 65-128.
- [7] Анисимов С.И., Гольберг С.М., Соболь Э.Н., Трибельский М.И. // Письма в ЖТФ. 1981. Т. 7. № 14. С. 882-887.
- [8] Fitzner K., Chang Y.A. - High-Temperature Superconductors II, Pittsburgh, USA, 1988. P. 285-288.
- [9] Соболь Э.Н. // ЖТФ. 1982. Т. 52. № 8. С. 1697-1699.

Поступило в Редакцию
8 февраля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 8

26 апреля 1989 г.

07; 12

ПСЕВДОГЛУБОКАЯ ГОЛОГРАММА

Ю.Н. Денисюк

Глубокие трехмерные голограммы, как известно, обладают рядом весьма полезных свойств: высокой спектральной и угловой селективностью, отсутствием сопряженного изображения, возможностью ассоциативной выборки информации, а также допускают реконструкцию обычным источником со сплошным спектром и т.д. [1-4]. К сожалению, получение таких голограмм связано с очень большими трудностями, обусловленными, в основном, ограниченными возможностями создания необходимых светочувствительных сред.

Ниже рассматривается возможность получения так называемых псевдоглубоких голограмм, т.е. записанных и восстановленных по специальной схеме тонкослойных голограмм, оптические свойства которых идентичны свойствам трехмерных голограмм, имеющих практически неограниченную толщину. Эта возможность появляется в результате ограничения класса регистрируемых объектов одно-